

新超精密加工プロセス技術と応用技術の提案

技術指導・企業内教育

装置・部材の販売

企業へ
橋渡し

人的ネットワークの紹介

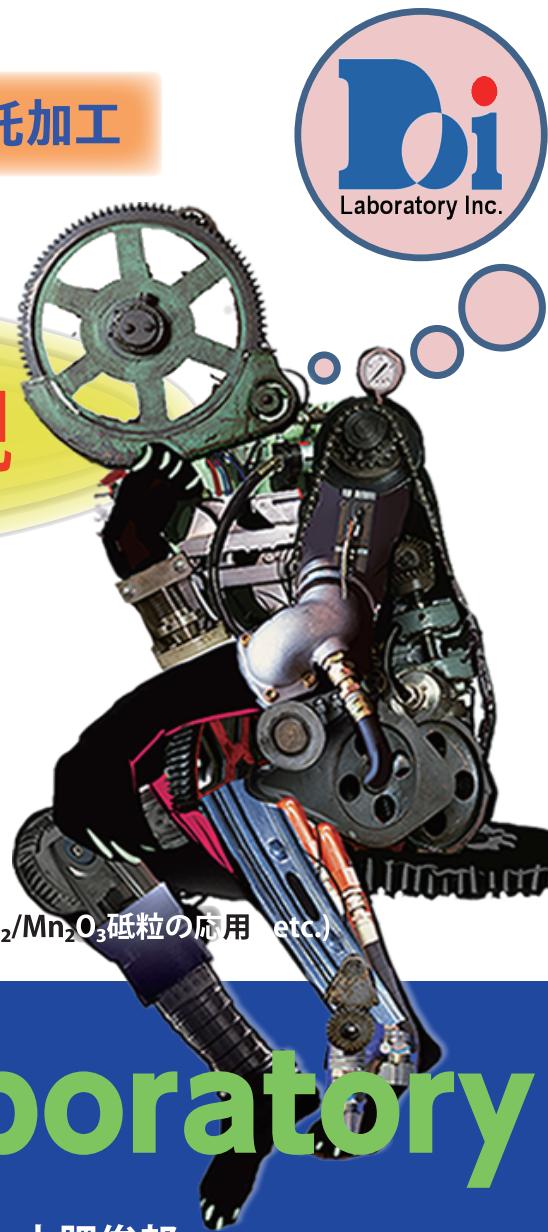
受託加工

CMPとメッキの研究開発に必須
“ダイナミック電気化学反応(d-EC)装置”
好評予約受付中

革新的高性能デバイスの実現

Keywords;

- 1) 超精密加工プロセス技術
- 2) CMP (Chemical Mechanical Polishing) 技術
- 3) 難加工材料の高効率加工プロセス
- 4) ダイラタンシー現象応用加工
- 5) プラズマ融合 CMP(Plasma Fusion CMP) 技術と応用
- 6) HPMJ(High Pressure Micro-Jet) 洗浄とその応用
- 7) 研磨技術史
- 8) その他 (ウェハボンディング、MEMS、ファインバブル水応用、MnO₂/Mn₂O₃砥粒の応用 etc.)



株式会社 Doi Laboratory



代表取締役 土肥俊郎

九州大学 名誉教授 埼玉大学名誉教授 理化学研究所 客員研究員
大連理工大学・浙江工业大学 客員教授

<http://www.doilaboratory.com>

福岡システム LSI 開発センター 401

福岡県福岡市早良区百道浜 3-8-33

〒814-0001 電話 (092) 986-3507

E-mail: toshiro.doi.883@m.kyushu-u.ac.jp

◎ 福岡空港 / 博多駅から地下鉄で藤崎駅で下車⇒Taxi (5分)

◎ JR 博多駅（博多口バスターミナル）から福岡タワー方面に乗車して
「福岡タワー南口」下車 (10秒)





Proposal of Ultra-Precision Processing Technology and its applications

**Technical assistance
and
industrial education**

**Sales of machines
and parts**

**Introduction of
personnel network**

Custom manufacturing

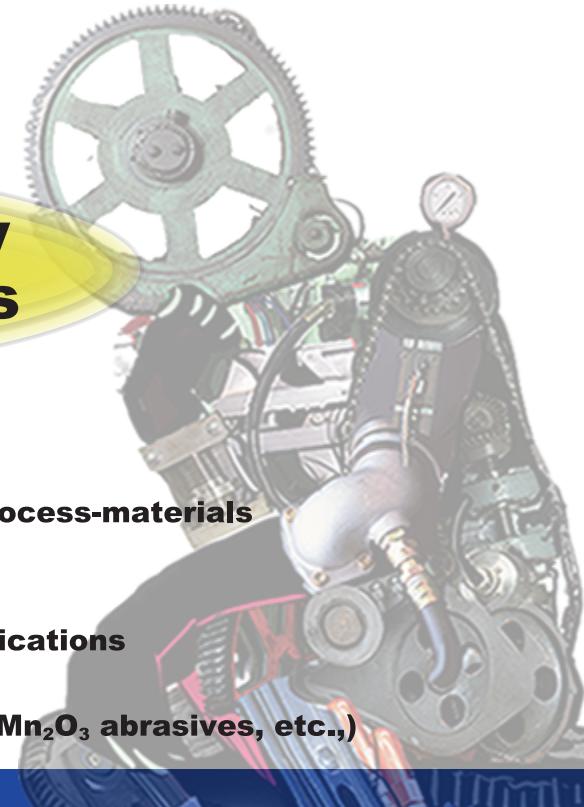
*Serving as a bridge
to the industries for*

*"Launched a new product and now accepting orders:
A Dynamic Electrochemical Reaction (d-EC) Machine,
an essential tool for CMP and Plating R&D"*

Realization of Innovatively High Performance Devices

Keywords:

- 1) Ultra-precision processing technology
- 2) CMP(Chemical Mechanical Polishing) technology
- 3) High performance manufacturing process for hard-to-process-materials
- 4) Dilatancy-applied processing
- 5) Plasma Fusion CMP technology and its applications
- 6) HPMJ(High Pressure Micro-Jet) technology and its applications
- 7) History of Polishing Technology
- 8) Others (wafer-bonding, MEMS, fine-bubble water, MnO₂/Mn₂O₃ abrasives, etc.,)



Doi Laboratory Inc.,

President **Toshiro Doi**



Emeritus Prof. of Kyushu Univ. & Saitama Univ.,
Visiting Researcher of RIKEN, Fellow of JSPE
Visiting Prof. of Dalian Univ. of Tech. & Zhejiang Univ. of Tech.,

<http://www.doilaboratory.com>

Fukuoka Institute of System LSI Design Industry Center 401
3-8-33 Momochihama, Sawara-ku, Fukuoka 814-0001, Japan
Phone +81-92-986-3507

E-mail:toshiro.doi.883@m.kyushu-u.ac.jp

Access:

From Fukuoka Airport/Hakata Station: take subway "Kuko Line" to Fujisaki. From Fujisaki, 5 minutes by taxi
From Hakata Station, take bus to Fukuoka Tower. 10 seconds to the office building



Entrepreneurship is Fukuoka! Active in the world!



新型超精密加工工艺及其应用技术的提案

技术指导 企业内部培训

设备、构件等销售

相关人际关系介绍

委托加工

CMP 和电镀研究开发所必须的
“动态电化学反应 (d-EC) 装置”
火热销售中

桥梁
构建
和企业
的

实现高性能加工的新型设备

Keywords;

- 1) 超精密加工工艺技术
- 2) CMP (Chemical Mechanical Polishing) 技术
- 3) 难加工材料的高效率加工工艺
- 4) 膨胀性现象的应用加工
- 5) 等离子体融合 CMP (Plasma Fusion CMP) 技术及应用
- 6) HPMJ (High Pressure Micro-Jet) 洗净及其应用
- 7) 研磨技术史
- 8) 其它 (晶片键合、MEMS、微气泡水的应用、MnO₂ / Mn₂O₃砂轮的应用等)



株式会社 Doi Laboratory

董事长 土肥 俊郎

九州大学名誉教授 琦玉大学名誉教授 理化研究所 客座研究员
大连理工大学 浙江工业大学 客座教授

<http://www.doilaboratory.com>

福冈系统 LSI 开发中心 401
福冈县福冈市早良区百道滨 3-8-33
电话 +81-92-986-3507



E-mail: toshiro.doi.883@m.kyushu-u.ac.jp

Access:

福冈机场 / 博多站乘地铁至藤崎站下车 打车 5 分钟
JR 博多站 (博多口公交站) 乘公交往福冈塔方向, 在福冈塔南口站下车 (10 秒)



来自福冈, 走向世界!